

FOUP300EX

FOUP (Front Opening Unified Pod)



Applications

- 300mm wafer process carrier

Features

- Single molded structure minimizing cleaning drying cycle time
- Entire ESD shell and door
- Excellent seal capability
- Secure roller clamping latch mechanism
- Long life including gasket
- Conforms to SEMI Standard
- Option : Thin wafer solution

用 途

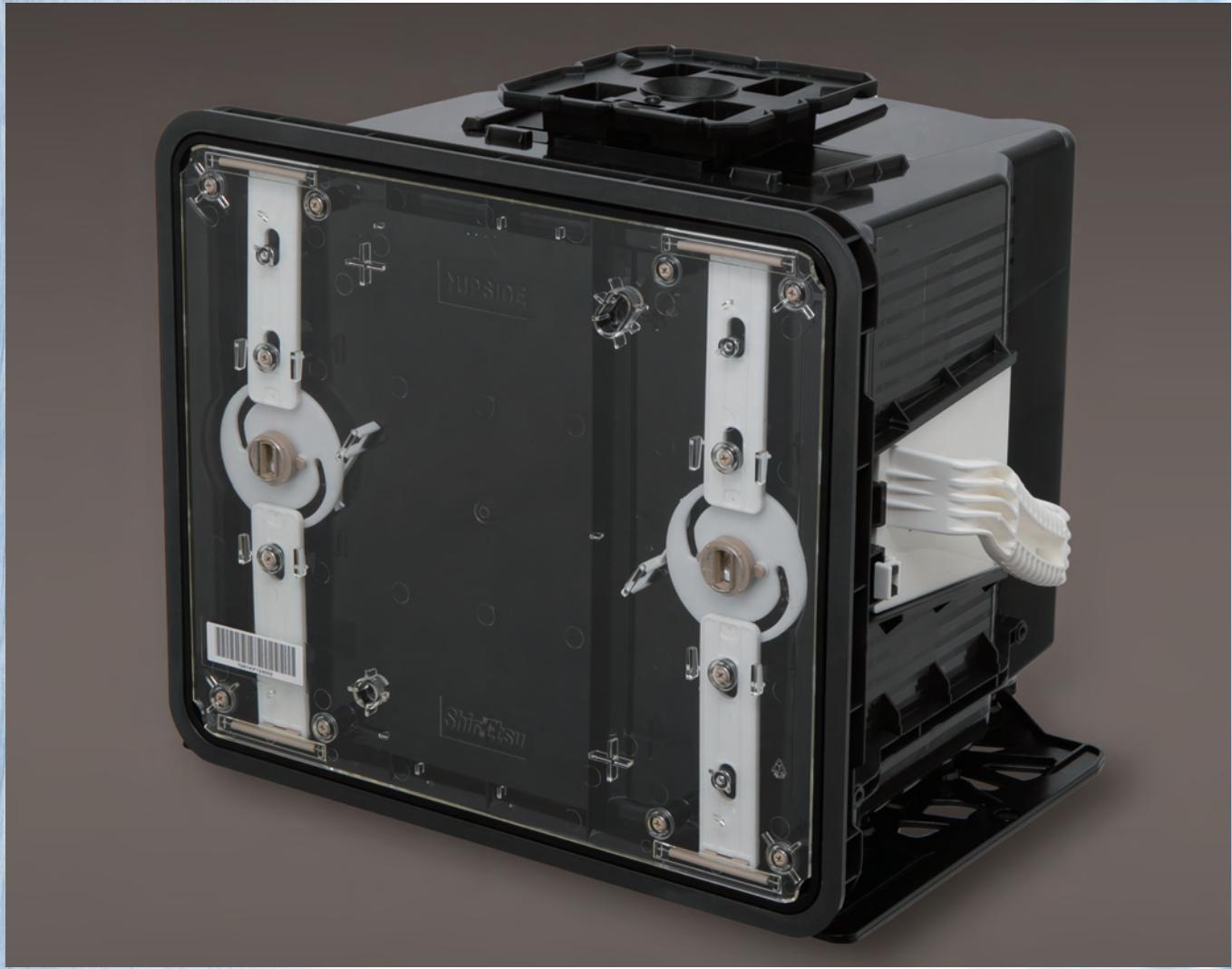
- 300mm ウエハープロセスキャリア

特 長

- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- ESDシェル、ドア
- 卓越したシール性
- 安全なローラーラッチ機構
- ロングライフ
- SEMI規格準拠
- オプション：薄ウエハ一対応

AQUAPROOF FOUP300EX

FOUP (Front Opening Unified Pod)



Applications

- 300mm wafer process carrier

Features

- Maintain the low moisture FOUP inside
- Single molded structure minimizing cleaning drying cycle time
- Entire ESD shell and door
- Excellent seal capability
- Long life including gasket
- Conforms to SEMI Standard
- Option:Advanced Diffuser(AD-SAP FOUP)

用 途

- 300mm ウエハープロセスキャリア

特 長

- FOUP内を低湿度に保持
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- ESDシェル、ドア
- 卓越したシール性
- ロングライフ
- SEMI規格準拠
- オプション:高速・高均一窒素パージ用パーツ

MW300GT

Automated FOSB (Front Opening Shipping Box)



Applications

- 300mm wafer shipper with automated door

用 途

- 自動化対応300mm ウエハー輸送用容器

Features

- Robust structure for perfect seal during transportation
- Manual open / close function
- Single molded Structure minimizing cleaning drying cycle time
- Conforms to SEMI Standard

特 長

- 輸送中のシール性を保つ高剛性構造
- マニュアル開閉機能付き
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- SEMI規格準拠

シンエツ ライトフレーム

ウエハーダイシング用樹脂製軽量テープフレーム

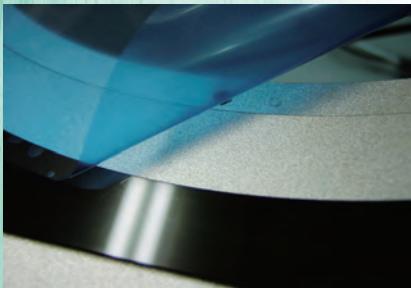
Shin-Etsu Lightframe SEMI G87-1108準拠(Φ300mm用)

工程間で発生する
導電性異物を排除し、
パッケージの信頼性を
向上させます。

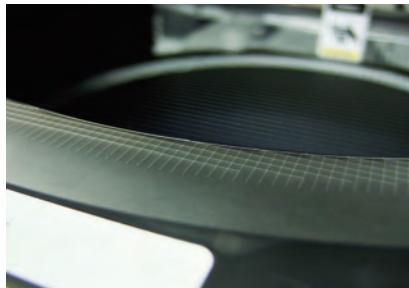


Applications

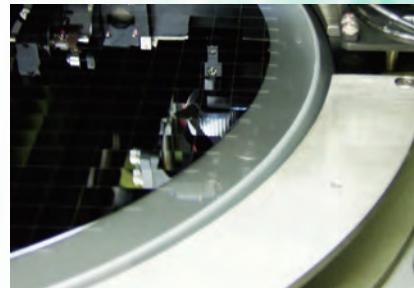
- Wafer dicing process carrier



【Technovision】
Wafer Mounting System
FM-Series (P-cut and normal tape)



【DISCO】
Fully Automatic Dicing Saw
DFD6361



【Shinkawa】
Die Bonder
SPA-300Super

用途

- ウエハーダイシングプロセスキャリア

Features

- Reducing Metal particles
- Light weight
- Usability
- Conforms to SEMI Standard

特長

- 金属異物低減
- 軽量化
- 作業性向上
- SEMI規格準拠 (Φ300mm用)

品番	Size	外径 (OD)	内径 (ID)	幅 (W)	厚み (H)	参考
300NLF-EP	300mm	400mm	350mm	380mm	2.5mm	ラベル対応タイプ
200NLF-EP	8 inch	296mm	250mm	276mm	2.0mm	ラベル対応タイプ
200NLF-FF	8 inch	296mm	250mm	276mm	2.0mm	フルフラットタイプ
150NLF-FF	6 inch	228mm	194mm	212mm	1.5mm	フルフラットタイプ

シンエツ キャリアテープ

Shin-Etsu Carrier Tape

高機能デバイス用小型チップを梱包可能

Available for taping high-performance small chips.

微細部品対応キャリアテープ Carrier tape for small chips.

特性値／Characteristic Value

- シート幅／Sheet width : 4.0~8.0mm
- シート厚／Sheet thickness : 0.2mm
- 材質／Material : APET, PS
- ピッチ／Pitch : 0.5mm, 1.0mm, 2.0mm

特長／Features

- チップの回転防止形状／Prevent Chip rotation
- 開口部R 最小化／Minimization opening radius (R)
- 底穴0.15φ対応可能／Available for center - hole (ϕ 0.15mm)
- 棚構造対応可能／Shelf pocket shape



シンエツトップカバーテープ

Shin-Etsu Top Cover Tape

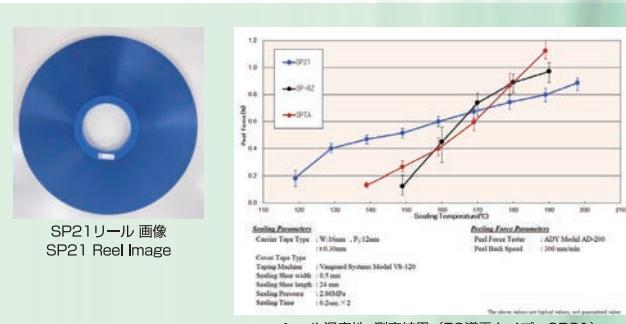
トップカバーテープSP21シリーズ Top Cover Tape SP21 Series

特性値／Characteristic Value

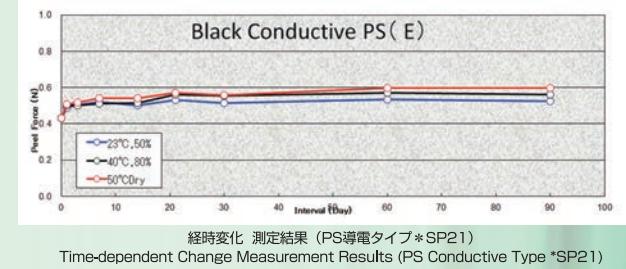
- 抵抗値／Resistance value : 7.4E+08Ω (PET面) (PET surface)
(導電タイプ) (Conductive type)
1.1E+08Ω (接着面) (Bonding surface)

特長／Features

- 高い透明性／High transparency
- 剥離タイプ：層間剥離／Peeling Type : Interlayer Peeling
- 高速テーピング可能／High-speed taping available
- 温度依存性が低い／Low temperature dependence
- ドーミングを低減／Reduction of film doming



シール温度性 测定結果 (PS導電タイプ*SP21)
Seal Temperature Resistance Measurement Results (PS conductive type *SP21)

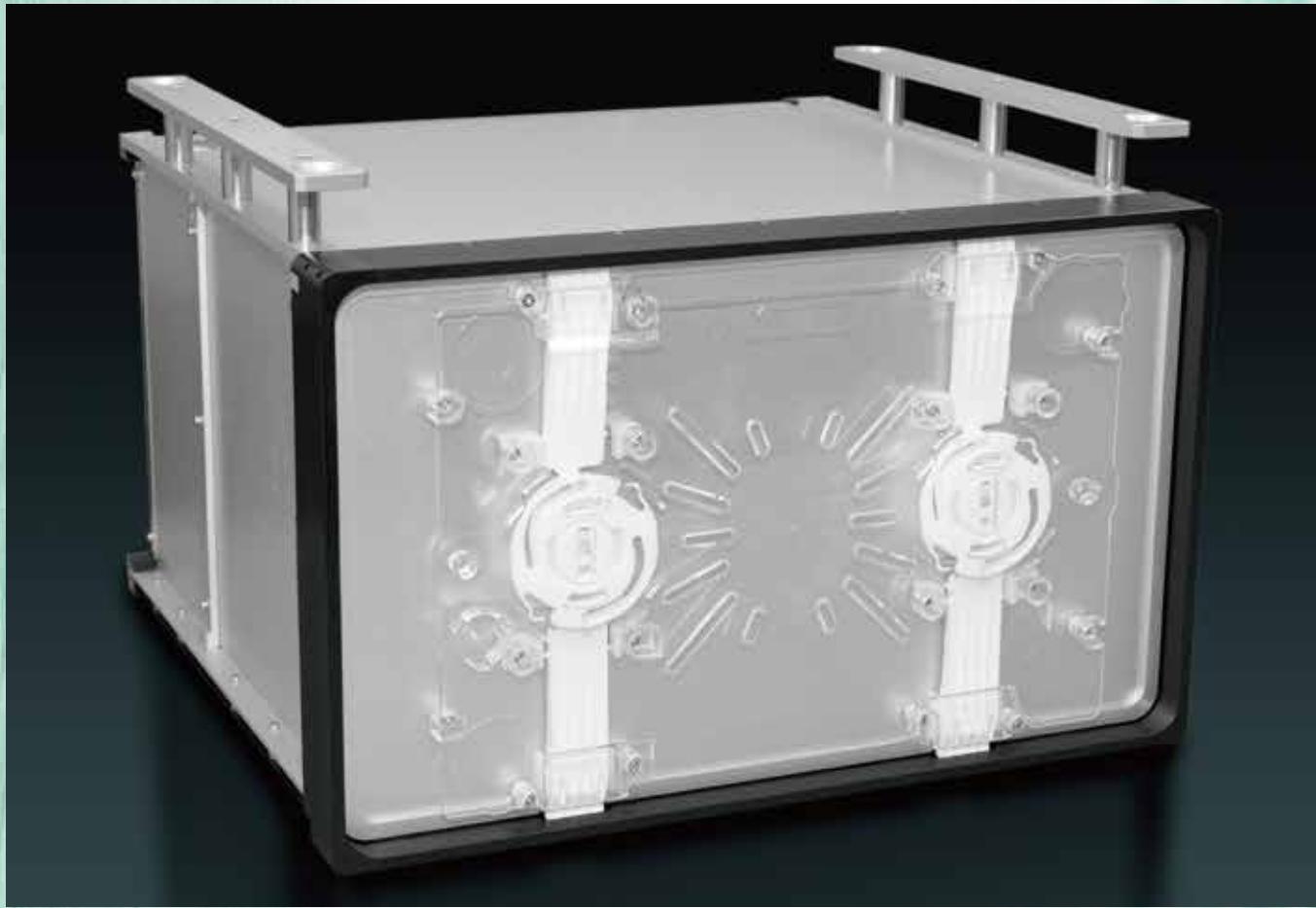


〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第二グループ
電話番号 03-5288-8414 FAX番号 03-5288-3113

ShinEtsu

PANEL FOUP

Front Opening Unified Pod for PLP



Applications

- Front Opening Unified Pod for PLP

Features

- Conforms to SEMI Standard
- Panel size :
600mm×600mm / 510mm×515mm
- 12 or 6 Slots
- FOUP size :
740mm×703mm×437mm(H) /
619mm×599mm×437mm(H)
- Weight : 29Kg / 26Kg
- Mechanical interfaces with load port ,
Manual open / close
- Humidity control

用 途

- パネルレベルパッケージ製造プロセス用

特 長

- SEMI規格準拠
- パネルサイズ :
600mm×600mm / 510mm×515mm
- 12スロット / 6スロット
- サイズ :
740mm×703mm×437mm(高さ) /
619mm×599mm×437mm(高さ)
- 重量 : 29Kg / 26Kg
- ロードポートによるメカニカルインター
フェイス、手動開閉可能
- 濡度コントロール

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413 FAX番号 03-5288-3113